证券代码:300971　　证券简称:博亚精工　　公告编号:2022-031

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本84,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博亚精工	股票代码	300971
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万涛		
办公地址	襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号		
传真	0710-3256426		
电话	0710-3333670		
电子信箱	boyabgs@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售,形成了两大产品线、数千种型号规格的精密制造体系;在钢铁、有色冶金行业的板带成形加工装备领域掌握了关键零部件制造技术和系统集成技术,成功打破国际垄断、实现了国产化、具备自主知识产权,成为该领域高端装备制造商;在特种装备领域瞄准客户对于高性能零部件的配套需求,将板带成形加工精密装备关键零部件的技术积累和制造经验运用于特种装备配套零部件的研发过程并不断进行技术创新,成功研制出高性能、高可靠性的特种车辆配套零部件、结构件产品,有效保障和提升装备性能,在特种装备配套领域建立了良好口碑与形象。

公司的板带成形加工精密装备及关键零部件产品主要定位于钢铁、有色冶金行业高端装备及零部件,已经成功替代德国、日本、意大利知名制造商的同类产品,其中部分装备及生产线机组产品成为了行业首创和标杆;公司与全球主要钢铁集团如宝武钢铁集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、日本制铁、韩国浦项制铁、印度JSW钢铁(印度京德勒西南钢铁公司)等的直属或合资公司均有合作,还与世界综合性冶金装备制造巨头意大利达涅利集团、我国最大的冶金建设运营商中国中冶集团的多家下属公司建立了良好的合作关系,在他们承建的多个大型冶金项目中将公司作为板带成形加工精密装备的配套供应商。

公司的特种装备配套零部件产品主要为特种车辆关键零部件和结构件,这些零部件对特种车辆装备在特殊严苛环境中的机动、适应性能有着重要影响,公司产品以过硬的质量和高可靠性在多种型号的特种车辆中广泛使用;公司配套的特种装备历经多次实战演练和国家级重大活动的检验,包括建国60周年国庆、纪念抗日战争胜利70周年、建军90周年、建国70周年国庆等,其产品性能得到了特种装备使用单位的广泛认可,与中国兵器等装备总装单位下属主机厂建立了长期稳定的配套关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,148,040,442.91	731,273,540.35	56.99%	653,295,991.69
归属于上市公司股东的净资产	897,418,734.78	498,715,910.08	79.95%	437,415,885.64
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	392,494,177.74	364,147,928.59	7.78%	295,621,646.03
归属于上市公司股东的净利润	85,773,325.25	83,793,083.33	2.36%	72,659,986.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,606,461.62	77,311,746.50	-3.50%	67,422,192.66
经营活动产生的现金流量净额	86,124,557.35	50,296,439.34	71.23%	69,141,489.68
基本每股收益(元/股)	1.110	1.33	-16.54%	1.15
稀释每股收益(元/股)	1.110	1.33	-16.54%	1.15
加权平均净资产收益率	11.36%	17.90%	-6.54%	17.61%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,491,562.03	101,339,772.23	75,434,369.77	130,228,473.71
归属于上市公司股东的净利润	21,137,248.04	28,639,288.29	22,479,689.52	13,517,099.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,553,578.85	22,569,597.85	21,898,776.21	10,584,508.71
经营活动产生的现金流量净额	-20,498,464.13	53,659,805.77	38,982,809.38	13,980,406.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,188	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李文喜	境内自然人	25.98%	21,826,000	21,826,000		
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.51%	4,630,112	4,630,112		
宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.41%	3,703,888	3,703,888		
铜陵鸿鑫领享投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	3,000,000	3,000,000		
王朝襄	境内自然人	3.40%	2,852,500	2,852,500		
武汉唯尔思股权投资基金管理有限公司-唯尔思壹号(咸宁)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	2,647,000	2,647,000		
岑红	境内自然人	2.86%	2,400,000	2,400,000		
陈思立	境内自然人	2.68%	2,249,000	2,249,000		
田瑞红	境内自然人	2.55%	2,145,000	2,145,000		
中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	1,200,000	1,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李文喜与岑红系公司实际控制人,为夫妻关系。宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)、宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为丰年通达。					

公司是否具有表决权差异安排

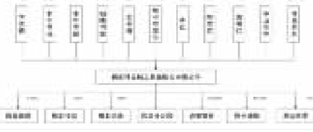
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]253号)核准,并经深圳证券交易所《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]392 号)同意,2021年4月15日,公司公开发行人民币普通股股票2100万股在深圳证券交易所创业板上市,公司股本由6300万股变更为8400 万股,证券简称为"博亚精工",证券代码为"300971"。

证券代码:300971　　证券简称:博亚精工　　公告编号:2022-029

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日,襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:300971　　证券简称:博亚精工　　公告编号:2022-030

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2022年一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日,襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2022年一季度报告〉全文的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年一季度报告》全文于2022年4月23日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:300676　　证券简称:华大基因　　公告编号:2022-042

深圳华大基因股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以409,914,184为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华大基因	股票代码	300676
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐茜	敖莉萍	
办公地址	深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层	深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层	
传真	0755-36307035	0755-36307035	
电话	0755-36307065	0755-36307065	
电子信箱	ir@bgi.com	ir@bgi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

华大基因作为中国基因行业的奠基者,秉承"基因科技造福人类"的愿景,通过20多年的人才积聚、科研积累和产业积淀,已建成覆盖全球百余个国家和全国所有省市自治区的营销服务网络,成为屈指可数的覆盖本行业全产业链、全应用领域的科技公司,立足技术先进、配置齐全和规模领先的多组学产出平台,已成为全球屈指可数的科学技术服务提供商和精准医疗服务运营商。

公司主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段,为科研机构、企事业单位、医疗机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。华大基因以推动生命科学研究进展、生命大数据应用和提高全球医疗健康水平为出发点,基于基因领域研究成果及精准检测技术在民生健康方面的应用,致力于加速科技创新,减少出生缺陷,加强肿瘤防控,抑制重大疾病对人类的危害,实现精准治愈感染,全面助力精准医学。

(1)生育健康基础研究和临床应用服务

公司基于高通量测序仪等创新型自主检测平台,遵循国家卫健委发布的《全国出生缺陷综合防治方案》相关要求,从出生缺陷三级防控角度出发,涵盖孕前、孕期、新生儿及儿童各阶段,开展与生育健康相关的基础研究和临床应用服务,旨在全面助力出生缺陷防控,提高儿童健康水平,保障妇幼健康。主要业务包括:NIFTY?胎儿染色体异常无创产前基因检测系列、多种单基因病无创产前检测、超声异常/引产组织高深度全基因组测序、EmbryoSeq胚胎植入前基因检测系列、康孕?染色体检测系列、觅因可遗传病基因检测系列(包含基于全外显子组、全基因组技术的检测)、安孕可单基因遗传病携带者筛查系列、耳聆可?遗传性耳聋基因检测系列、地中海贫血基因检测系列、安馨可TM新生儿及儿童基因检测系列等。

公司基于高质量临床质谱检测服务平台,开发了一系列的医学检验产品,包括新生儿遗传代谢病筛查、新生儿先天性肾上腺皮质增生症检测、新生儿溶酶体贮积症检测、孕期营养检测、人体氨基酸检测、人体维生素检测、人体胆汁酸谱检测等产品。

(2)肿瘤防控及转化医学类服务

公司围绕多类肿瘤构建肿瘤"预、筛、诊、监"闭环,并通过技术和产品的不断升级,建立全面有效的防控体系。公司面向受检者提供癌症风险评估以及靶向治疗和免疫治疗等用药指导和复发监测信息,为各级医疗机构提供基于高通量测序、PCR、酶联免疫、化学发光等技术的检测试剂,并且与国内外知名医药企业合作开展致病机理发现、生物标志物开发、药物靶标确认和药物风险管控等全套药物基因组学研究业务和肿瘤临床研发业务。主要服务包括:遗传性肿瘤基因检测、HPV分型基因检测、无创癌症筛查基因检测、多组学肿瘤标志物测定、肿瘤个体化诊疗和用药指导基因检测和肿瘤微小残留病灶(MRD)定制化检测等。报告期内,公司进一步拓展妇科肿瘤及血液肿瘤领域的产品布局,推出华妍安子宫内膜癌分子分型和华雪安TM白血病基因检测。

公司专注于肿瘤早筛业务和数据服务的子公司华大数极已上市华常康无创肠癌基因检测及其"筛诊保"闭环解决方案和华甘宁无创肝癌基因检测,未来将陆续推出其他高发癌种早筛系列产品。

(3)感染防控基础研究和临床应用服务

华大基因利用宏基因组学等多个技术平台对疑难危重感染进行检测和分析,建立了多种病原检测的技术与产品体系,覆盖了不同客户人群多层次的检测需求,成为临床诊断的重要辅助手段。其中,基于宏基因组学的PMseq病原微生物高通量基因检测根据不同病原类型(DNA或RNA病原体)以及不同的检测灵敏度,从血流感染、中枢神经系统感染、呼吸系统感染及局灶感染四大症候群维度,针对不同标本类型,细化升级出基础版/高敏版的PMseq-DNA、PMseq-RNA、PMseq-DNA+RNA病原微生物高通量基因检测产品。报告期内,公司对细菌耐药基因多重检测产品进行了全新升级,可检测5种常见病原微生物和导致细菌耐药相关的9个蛋白酶基因。报告期内,公司新发布PM Easy Lab 全自动核酸检测系统,可一站式处理从核酸提取到检测出报告的全过程;并基于此平台完成了中枢神经系统感染病原体核酸多重检测、呼吸道病原体核酸多重检测产品的开发,为中枢神经系统感染和呼吸道感染患者提供快速的病原学检测结果。同时,公司基于液相色谱串联质谱技术的抗菌药物浓度检测产品,可为医生制定用药处方提供参考依据。

新型冠状(以下简称新冠)病毒肺炎疫情在全球范围内爆发,公司第一时间研发出多项新冠病毒检测试剂盒。报告期内,公司针对多联检检测、核酸快速检测、不同变异株检测的市场需求,加大研发资源投入,相关检测试剂盒均已获得欧盟CE准入资质。目前,公司已形成病毒测序、核酸检测、核酸快检、抗原快检、抗原自测、抗体快检、中和抗体检测等多产品覆盖体系,技术覆盖荧光PCR法、联合探针锚定聚合测序法、酶联免疫吸附测定法、胶体金法、荧光免疫层析法、自驱动微流控-试纸条法等,满足不同地区及人群的疫情防控需求。

(4)多组学大数据服务与合成业务

公司率先面向合作伙伴提供多组学大数据服务,致力于成为全球生命科学研究机构的卓越合作伙伴,为从事生命科学研究的机构和企业提供高质量、行业领先的多组学大数据全流程系统解决方案。该服务面向的主要客户为以高校、研究性医院等为代表的科研机构,以及以药企、育种公司等为代表的工业客户。多组学大数据服务业务主要包含基因测序、质谱分析、生物数据库管理、数据云分析等标准化技术服务和全流程系统解决方案。通过先进的测序与分析平台,公司多组学大数据服务还可提供非编码RNA、目标区域测序、表观基因组、基因分型、蛋白类产品、代谢类产品、单细胞类产品、免疫组库测序、基因组学数据库等产品。通过上述技术手段的集合,多组学大数据服务形成了一整套可贯穿的"组学"研究方法,可以为生物学研究提供全面系统的研究方案与生态链体验服务。

合成类业务主要包含基因合成、Oligo合成等。其中,基因合成业务包括合成密码子优化过的cDNA、特殊位点突变的基因、人工设计的DNA序列,公司可提供包含目的基因的质粒;Oligo合成则是利用化学方法合成特定的已知序列的寡核苷酸片段,主要应用于反义寡聚核苷酸、测序与扩增的引物、DNA杂交、探针、点突变以及全基因合成等实验中。

(5)精准医学检测综合解决方案

公司在精准医学领域坚持"自主研发为主、生态合作为辅"的战略,凭借强大的研发能力、丰富的临床转化能力及高性能的自主平台,公司已经建立了以高通量测序平台、高分辨质谱平台为基础,传统检验平台为辅助,生命大数据为核心的精准医学综合解决方案。针对综合实力强、业务量大的医疗机构,公司可提供经国家药监局批准可用于临床应用的高通量基因测序仪以及配套检测试剂盒、高分辨质谱仪以及配套试剂盒、高性能大数据分析及储存平台,协助建立以测序技术和质谱技术为基础,以多组学大数据为核心的精准医学检测平台,实现科研、临床的一体化,加速新技术在临床应用的转化。

公司在科研和产业化过程中形成了庞大的数据积累,在生物样本和表型数据的基础上,采用测序、质谱、PCR等多维度技术对生物样本进行多组学的数据化,利用智能化技术、数据挖掘系统和生物信息学分析工具对海量数据进行充分整合和分析,提高医疗健康行业对疾病的发生、发展、终结以及复发全过程的全面认知。精准医学检测整合了前沿科学技术与传统医学方法,为健康中国实现提供了贯穿全生命周期的新型医学综合解决方案,未来将有望赋能全球生命健康产业。

2020年新冠疫情在全球范围内爆发,为解决各地区新冠病毒检测通量不足的问题,公司推出了"火眼"实验室一体化综合解决方案,为落地"火眼"实验室的地区输出检测技术和设备,并为当地实验室人员提供培训和技术支持等服务,"火眼"实验室在全球各地批量建成并高效助力各国疫情防控工作。此外,为解决跨境人员快速检测的服务需求,公司率先推出了机场"火眼"实验室解决方案,除目前已经运行的香港、阿曼机场"火眼"实验室外,报告期内在埃塞俄比亚落地了非洲机场"火眼"实验室。

公司多元化的新冠检测综合解决方案,尤其是移动版"火眼"实验室在极致化交付方面具有显著优势。报告期内,针对国内部分地区疫情散发、国际疫情突发的情况,公司充分发挥气膜"火眼"实验室通量高、建设速度快的优势,助力全球抗疫,分别在支援石家庄、广州、佛山等国内城市和巴布亚新几内亚、文莱等国家的散发、突发疫情防控中发挥了重要作用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	14,254,029,629.93	11,195,040,535.59	27.32%	5,909,118,302.73
归属于上市公司股东的净资产	9,318,407,626.12	5,910,105,053.53	57.67%	4,314,048,690.33
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,766,137,315.11	8,397,230,002.83	-19.42%	2,800,411,936.69
归属于上市公司股东的净利润	1,461,536,272.38	2,090,285,273.48	-30.08%	276,334,018.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,358,342,523.98	2,049,045,082.77	-33.71%	221,481,259.05
经营活动产生的现金流量净额	2,476,132,383.90	3,602,692,531.30	-31.27%	224,254,961.96
基本每股收益(元/股)	3.5643	5.2520	-32.13%	0.6907
稀释每股收益(元/股)	3.5502	5.2353	-32.19%	0.6907
加权平均净资产收益率	17.31%	40.44%	-23.13%	6.27%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,563,364,152.52	2,082,845,540.00	1,505,833,804.01	1,614,093,818.58
归属于上市公司股东的净利润	524,980,701.18	561,036,671.12	328,216,516.53	47,302,383.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,667,084.22	488,920,792.39	285,283,296.05	43,471,351.32
经营活动产生的现金流量净额	132,257,506.56	532,353,573.39	1,090,840,490.61	720,680,813.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,675	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳华大基因科技有限公司	境内非国有法人	35.94%	148,773,893	148,773,893	质押	79,657,600
深圳前海华大基因投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.33%	34,470,455	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.56%	14,715,224	0		
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.74%	11,333,314	0		
深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.70%	7,037,666	0		
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青私募证券投资基金	其他	0.98%	4,037,106	0		
深圳华大三生园科技有限公司	境内非国有法人	0.95%	3,935,824	0	质押	1,000,000
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.73%	3,032,867	0		
何倩兴	境内自然人	0.68%	2,820,936	0		
汪建	境内自然人	0.53%	2,209,400	1,657,050		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,汪建是深圳华大基因科技有限公司(以下简称华大控股)的控股股东,华大控股是深圳华大三生园科技有限公司(以下简称华大三生园)的控股股东;华大控股的董事长兼总经理汪建是华大三生园的董事。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20华大01	149105	2020年04月24日	2022年04月27日	30,000	3.50%
深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20华大02	149106	2020年04月24日	2022年04月27日	20,000	3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年4月22日在巨潮资讯网发布《2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告》(公告编号:2021-040),公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于2021年4月27日支付自2020年4月27日至2021年4月26日期间的利息,本期债券品种一"20华大01"和品种二"20华大02"的票面利率为3.50%,每10张债券(面值为人民币1,000元)派发利息为人民币35.00元(含税)。报告期内,公司已完成本期债券品种一和品种二的利息支付,共计1,750万元人民币。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月23日,联合资信评估股份有限公司出具了《深圳华大基因股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》(联合〔2021〕4965号),公司主体长期信用等级为AA,"20华大01"和"20华大02"信用等级为AAA,评级展望为"稳定"。报告期内资信评级机构对公司及公司债券的评级未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	33.76%	46.17%	-12.41%
扣除非经常性损益后净利润	135,834.25	204,904.51	-33.71%
EBITDA全部债务比	148.51%	145.94%	2.57%
利息保障倍数	17.67	28.43	-37.85%

三、重要事项

报告期内,公司秉承"基因科技造福人类"大目标,坚持"防大于治、人人可及"的公共卫生普惠精准防控理念,主动战略性调整新冠相关产品结构与供应链策略,继续聚焦主营业务,持续加大研发投入,加速提升全球市场份额,公司整体营业收入较上年同期新冠疫情突发大幅增长的基数基础上有所下降,剔除新冠业务变化情况,公司常规业务保持了稳健发展态势。报告期内,公司实现营业收入676,613.73万元,同比下降19.42%;实现归属于上市公司股东的净利润146,153.63万元,同比下降30.08%。报告期内,公司继续加大研发投入力度,研发投入总金额为54,219.02万元,占同期营业收入比例为8.01%。

报告期内公司经营情况未发生重大变化,报告期内经营情况详见公司《2021年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"。

证券代码:300400　　证券简称:劲拓股份　　公告编号:2022-007

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以239,664,980股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

说明:截至本报告披露日,公司总股本为242,625,800股,其中公司回购专用账户中的股份2,960,820股不享有利润分配权力,因而剔除公司回购专用账户中的股份数量后,公司本次利润分配的总股本基数为239,664,980股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	劲拓股份	股票代码	300400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张娜	黄山	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)	
传真	0755-89481574	0755-89481574	
电话	0755-89481726	0755-89481726	
电子信箱	zqtzb@jt-ele.com	zqtzb@jt-ele.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品情况

公司主要从事专用设备的研发、生产、销售和服务,主要产品按大类可以划分为电子热工设备、检测设备、自动化设备、光电显示设备和半导体专用设备等。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

截至本报告披露日,公司基于成本管控、产品功能、应用领域和组织生产形式等因素的考量,业务层面的组织架构及产品分类进行了调整。

公司业务层面:继续推行事业部制,但在事业部内部推行项目部制。目前公司业务层面设立电子热工事业部,其他业务事业部统一整合为光电事业部,其中事业部中按照产品属性设立了多个项目部。同时公司设立控股孙公司思立康及至元发展半导体业务。通过内部业务资源整合,强化目标责任管理,层层分解目标责任,以期做到层层知责、层层担责、层层尽责。

产品分类方面:由电子整机装联设备、光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组生产专用设备调整为电子热工设备、检测设备、自动化设备、光电显示设备和半导体专用设备,调整后的主要业务及产品情况如下:

1、电子热工设备

公司自成立以来,一直从事电子热工设备的研发、生产和销售。公司电子热工设备、检测设备和自动化设备覆盖电子产品PCB生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程,为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统,主要提供给下游电子制造企业,用来组建电子工业中的PCBA生产线,该类设备能够广泛应用于通讯、汽车、消费电子产品及国防、航空航天电子产品等生产过程。

公司电子热工设备应用领域示例如下:

应用行业	涉及产品
消费电子制造业	电脑、数码产品(手机、数码相机、平板电脑、智能可穿戴设备、移动存储、电子书等)、家庭影音娱乐产品(电视机、音箱、游戏机等)、白色家电(空调、电冰箱、洗衣机等)、小家电(电饭锅、微波炉等)、LED显示器等。
汽车电子制造业	汽车信息系统(行车电脑)、导航系统(GPS)、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。
通信设备制造业	移动通信基站、路由器、程控交换机、服务器等。
航空航天制造业	各类仪表仪器、无线通信、导航卫星。
国防电子制造业	各类侦测仪器、雷达、指挥控制系统。
其它电子制造业	打印机、复印机、投影仪等。

电子热工设备由公司自主研发、生产和销售,拥有温度控制及传热方面的核心技术,此类产品主要功能是将表面贴装元器件与PCB进行组装,应用于电路板组装制程领域,客户为电子产品生产厂家。

公司电子热工设备主要产品情况及应用领域如下表:

主要产品		主要功能及应用领域
回流焊	真空回流焊	真空回流焊是在回流焊接过程中引入真空环境的一种回流焊接技术,真空回流焊是在产品进入回流焊接区后端,再进入一个真空环境的腔体,大气压可以降低到5mbar以下,并保持一定的时间,实现真空与回流焊接的结合,此时焊接点仍处于熔融状态,而焊点的外部环境接近真空,由于焊点内外压力差的作用下,使得焊点内的气泡很容易从中溢出,使焊点的空洞率大幅降低。 主要应用领域为车载控制板及LED、新能源IGBT模块、通讯电子、5G等。
	AKT系列热风氮气无铅回流焊	LED元器件通过传送系统进入设备里各个设定的温度区域,经过焊料预热、熔化、润湿、冷却,将各种贴装或者固晶完成的LED芯片元器件焊接到印制基板上;LED焊点及间距较小,整个的工艺过程要在全程低氧浓度下(小于50PPM)完成。 主要应用领域为Mini LED直显和背光的IMD、COB、COG等封装工艺。
	KT系列热风无铅回流焊	主要功能是将电子基板与SMT表面贴装元器件通过焊锡膏合金可靠的焊接在一起的设备。 主要应用领域为智能手机、通讯、汽车电子、服务器、航空、军工等高品质要求的产品。
	JTR系列热风无铅回流焊	主要功能是将电子基板与SMT表面贴装元器件通过焊锡膏合金可靠的焊接在一起的设备。 主要应用领域为智能手机、通讯、电脑、家电等中高品质要求的产品。
	TEA系列热风回流焊	主要功能是将电子基板与SMT表面贴装元器件通过焊锡膏合金可靠的焊接在一起的设备。 主要应用领域为家电电子PCB、小功率电源板、一般电子控制板、LED等产品。
波峰焊	全程氮气波峰焊	自动完成PCB板从涂覆助焊剂、预加热、焊锡及冷却等焊接的全部工艺过程,主要用于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混装型PCB板的整体焊接。 主要应用于通讯、汽车电子、服务器、航空、军工等高品质要求的产品。
	GXS系列高端无铅波峰焊	实现大热容量PCB电子元器件(大电容、大电感)钎接,满足4mm厚度PCB透锡能力。预先装插好各类电子元件的PCB,以特定的工艺要求,实现助焊喷涂、产品预热、波峰钎接(部分大功率电源产品为保障焊点的可靠性要求氮气保护)、冷却完成元件焊点钎接过程。 主要应用领域为储能产品、服务器类主板、充电桩大功率电源主板、高端汽车电子产品等。
	EXS系列无铅波峰焊	主要满足一般消费家电产品装联需求,即一般电子产品装插元件后,通过设备实现喷雾、预热、焊接、冷却后自动形成可靠焊点。 主要应用领域为白色家电电子PCB、小功率电源板、一般电子控制板等。
固化炉	立式固化炉	主要应用于三防漆、填充胶等的固化。通过热风回流加热产品,在某个温度范围内保持一定的时间以完成胶水的凝固,此机种占地面积小,生产效率高,可实现在线式生产。 主要应用于手机主板、电脑主板、电视主板、通讯主板、新能源等相关电子产品的生产。
	洁净式烤炉	主要应用于Underfill、水胶、填充胶等的固化,通过热风回流加热产品,在某个温度范围内保持一定的时间以完成胶水的凝固。主 要应用于摄像头模组、半导体芯片、手机屏等产品。
选择焊	NIS系列选择焊	高端模块化选择性波峰焊的应用,软件平台智能化,功能集成化,高精度化,满足客户DIP焊接的各种焊接需求。
	SH-3D系列选择焊	模块化选择性波峰焊的应用,第一代一体机,满足客户DIP焊接的各种焊接需求。
	MIS系列选择焊	小型化选择性波峰焊的应用,集成化焊接平台,满足客户小场地的生产需求,节约客户的厂房使用。满足客户DIP焊接的各种焊接需求。
	EIS系列选择焊	经济型模块化选择性波峰焊的应用,软件平台智能化,功能集成化,高精度化,满足客户DIP焊接的各种焊接需求。

2、检测设备

检测设备由公司自主研发、生产和销售,拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术,此类产品主要功能是在电子产品生产中对PCB上焊点和元器件进行检测,应用于电路板组装制程领域,与电子热工设备组成一条SMT生产线,客户为电子产品生产厂家。

公司检测设备主要产品情况及应用领域如下表:

主要产品		主要功能及应用领域
自动光学检测设备(AOI)	在线单轨/双轨AOI	应用于贴片工艺错件,漏件,反向,焊接不良,偏位等外观检测。
	离线单轨/双轨AOI	离线设备,应用于贴片工艺错件,漏件,反向,焊接不良,偏位等外观检测。
	双面检测AOI	应用于波峰焊后面的焊点,错件,漏件,反向等外观检测。
	炉前AOI	应用于炉前错件,漏件,反向外观检测。
	Mini Led检测AOI	应用于Mini Led的漏件,极性,共线性检测。
自动锡膏检测设备(SPI)	Refine系列SPI	用于PCB板印刷后检测出锡膏或者红胶的厚度、面积、体积、偏移的分布情况,专用于检测锡膏印刷质量的设备,可起到改善锡膏印刷质量的作用。Refine1200-1800设备轨道运输负载大,尺寸长,用于汽车LED灯板,电池连接器等超大尺寸PCB板。
	Mini/Micro LED SPI	设备相机精度高、运动速度快,用于手机、Mini LED等密度高、元器件精密的PCB板。
智能激光指示仪		用于激光指示不良点位置,复判后指示维修。

3、自动化设备

自动化设备主要为与公司电子热工设备和检测设备配套使用的相关设备,包括异形插件机、助焊剂喷雾机及其他电子热工周边设备等,其中异形插件机主要功能是对各种规格的散装料或排插等异形电子元器件的插件处理,可以替代人工,实现自动化插件,客户为电子产品生产厂家。

公司自动化设备主要产品情况及应用领域如下表:

主要产品		主要功能及应用领域
插件机	全自动异形元件插件机	主要应用于电子产品生产过程对各种规格的散装料或排插等异形电子元器件的插件处理,可以替代人工,提升插件速度,通过简单易懂的操作界面,实现人机界面的对话,实现自动化的机器导入,带来产品品质和生产效率的提升。
	单悬臂高速插件机	
供料器	多盘盘式供料器ATS	适用于盘装物料的自动供料,一次可上12盘物料,为插件机配套供料器设备。
	双托盘式供料器	适用于盘装物料的自动供料,人工可在不停机的情况下交替换盘,为插件机配套供料器设备。
	编带供料器	适用于编带物料的自动供料,为插件机配套供料器设备。
	散装振动盘供料器	适用于散装物料的自动供料,为插件机配套供料器设备。
	管装供料器	适用于管装物料的自动供料,为插件机配套供料器设备。
助焊剂喷雾机		主要应用于在波峰焊工艺中对PCB载具进行助焊剂喷涂,其中选择性助焊剂喷雾机可通过编程实现对指定位置进行喷涂。
电子热工周边设备		主要应用于SMT或者DIP生产线中,通过这些小型设备将其他生产设备串联起来,实现各种设备之间的自动化生产,如上下料机、接驳台、转角机、出板机、入板机等。

4、光电显示设备

报告期内,公司对光电显示业务进行整合,目前光电显示设备暨TP/LCD/OLED显示模组相关业务由光电事业部负责,光电事业部在公司战略规划下统一管理公司各类光电显示设备的研发、生产、销售和服务。

公司光电显示业务主要研发和生产用于手机屏幕制造等不同工艺阶段的光电显示设备,主要用于光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组的生产制造过程,按功能分类主要有3D贴合设备、生物识别模组生产设备、LCM焊接类设备、贴附机等,相关产品已经覆盖AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域,主要客户为国内大型面板制造商和模组生产商。

公司光电显示设备主要代表性产品和功能如下:

主要产品		主要功能
3D贴合设备	3D曲面贴合设备	设备是将3D盖板玻璃在真空状态下进行贴合,能应用于贴合装饰膜、防爆膜、Sensor膜、光学膜等。
	D-Lami贴合设备	用于柔性OLED屏与曲面玻璃盖板的贴合。
	车载屏贴合设备	用于车载屏的CG+TP+OCA+OLED显示屏+黑膜、防爆膜+CG盖板贴合等工艺,包括车载屏Sheet贴合设备、防爆膜Sheet贴合设备等。
	折叠屏贴合设备	用于折叠屏OLED、固定支架、SUS+Panel贴合,包含Cover Film/UTG -Lami设备、Bracket-Lami贴合设备、SUS-Lami贴合设备、散热膜贴合设备、保护膜贴合设备等。
	其他贴合及辅助设备	包含上&下覆膜机、全贴合机、半导体铜片贴合设备等设备,主要系3D贴合设备相关辅助设备及应用于其他模块的贴合设备。
生物识别模组生产设备	超声波指纹模组邦定设备	设备用于将指纹识别Sensor与FPC(柔性线路板)之间的邦定连接。将已完成IC邦定的显示屏面板,进行FPC(柔性线路板)邦定制程,含ACF贴附、FPC高精度对位预压、FPC本压、点胶四个主要工序。
	超声波指纹模组贴合设备	超声波指纹模组IC+Sensor贴合设备。
	光学指纹模组封装贴合设备	主要用于光学指纹模组的贴合、贴附、封边点胶及固化。
LCM焊接类设备	全自动焊接机	在液晶模组(LCM)的制程中,将玻璃与背光源/盖板的FPC自动进行拨片夹持整理、视觉对位、喷涂助焊剂等工艺处理,再使用脉冲热压焊接或者烙铁头焊接的方式将两者焊接牢固,并具有焊后AOI检测、高度测量、高温胶纸贴附等功能。
贴附机	焊盘检测贴附机	可广泛应用于LCD行业的中高端客户,完善焊接后的清洁检测和胶纸贴附工艺和功能,适用于工业4.0无人化产线的生产需求。
	导电胶贴附机	适用于穿戴类屏体上导电胶贴附,实现自动Tray上下料、铜箔贴附、导电胶贴附、AOI检测等功能。

5、半导体专用设备

公司半导体专用设备业务主要研发和生产用于半导体生产过程的专用设备,包括半导体热工设备和半导体硅片制造设备。半导体热工设备主要是用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备,半导体硅片制造设备主要用于半导体硅片生产过程。公司半导体专用设备目前主要有半导体芯片封装炉、Wafer Bumping焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、半导体硅片制造设备等,主要客户及潜在客户为半导体封测厂商、半导体器件生产厂商和半导体硅片生产厂商等。报告期内,公司设立了控股孙公司思立康发展半导体热工业务,设立了控股孙公司至元发展半导体硅片制造设备业务。

公司半导体专用设备主要代表性产品和功能如下:

主要产品		主要功能及应用领域
半导体热工设备	半导体芯片封装炉	主要是应用于各类芯片元器件的封装过程。预先在基板的焊盘上涂上焊料,把芯片等元器件固定,再进入封装炉设备,经过传送系统及各个设定的温度区域,焊料经过预热、熔化、润湿、冷却,将元器件封装到印制基板上,整个工艺过程要在低氧(小于25PPM)环境中完成。
	Wafer Bumping焊接设备	主要应用于晶圆级封装(WLP),可以在6"、8"、12"晶圆基板上,通过pillar pumping、Gold pumping、Solder Ball Drop等工艺,形成一种金属凸点,此凸点常见的有圆形及圆柱形,是晶圆制造中这个重要的工序。
	甩胶机	在高速旋转的晶圆(Wafer)表面,完成松香均匀的涂敷(Flux coater),是Wafer Bumping的前一道工序设备,为进入下一工序做准备,是晶圆植球工艺中重要的工序之一。
	氮气烤箱	主要应用于胶水的静置及固化,使胶水尽可能的填充被焊接有缝隙及容易受污染的元件周围,整体提高产品的可靠性能。
半导体硅片制造设备		主要用于半导体硅片的生产制造过程,服务于半导体元器件和集成电路制造领域。

(二)主要经营模式

1、销售模式

(1)在国内市场采取直销为主代理商销售为辅的销售模式

公司产品以内销为主,在国内市场上,公司采取订单直销为主,代理商销售为辅的销售模式。公司拥有自己的独立销售团队,可以直接与客户进行产品信息沟通,及时了解客户需求,把握市场动向。公司订单的获得方式主要为客户上门或主动营销。另外,公司还积极通过举办行业技术及工艺交流会、产品推介会以及参加国内外各种专业展会、招标会的方式获得订单。

对于公司销售网络未覆盖到的市场区域,公司实行代理商机制,各代理商均负责一定区域或具体客户单位的产品销售工作,公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道,不定期地向代理商提供宣传资料、信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。

(2)在国际市场采取直销与经销商销售相结合的销售模式

目前公司产品出口销售占比较小,在国外市场,公司采取直销与经销商销售相结合的销售模式。

2、生产模式

公司实行"以销定产"的生产模式,即根据销售订单来制定公司的生产计划。在电子热工设备、检测设备、自动化设备生产方面,公司拥有钣金、机加及装配等完整的全工序生产制造体系,能够采取自主标准化生产模式,公司下设PMC部全面负责协调管理生产系统的工作,由PMC部按销售部门下达的订单指令组织安排钣金车间、机加车间、装配车间进行生产,并和品质部、货仓部等部门共同配合,负责原材料入库、产品生产、产品测试、质量控制和产品发运的全过程;在光电显示设备生产方面,产品属于专用设备,定制化特点突出,产品种类型号较多,在生产实践中公司总结了一套与此特点相适应的小量多批次的柔性化生产模式,能够根据客户需求进行定制化生产;在半导体专用设备生产方面,根据产品特点,采用标准化生产与定制化生产相结合的生产模式。公司启用了SAP系统,对生产成本进行有效管控。新产品开发和生产过程中,研发部门和生产部门紧密配合,及时解决生产中遇到的问题,保证新产品生产进度和质量。

3、采购模式

在采购交货管理方面,公司采购部门按照PMC部门下发的请购单进行采购,严格遵循"同一质量水平比价格、同一价格水平比质量、同一质量价格水平比服务"的三比采购法原则,确保交期基本与生产计划衔接,同时公司严格根据销售、生产和原材料情况,确定采购需求,避免存货积压。在供应商选择方面,公司严格按照《供应商评审与管理程序》对供应商的品质、供货能力进行详细评审,通过评审的供应商成为合格供应商,公司会择优选择供应商,从而保证产品质量和客户满意度;在关键物料方面,公司主要采用知名品牌产品,与供应商建立长期合作关系,确保供货及时;在常规物料方面,在保证产品品质及交期的前提下,公司会通过询、比、议价,选择品质稳定、价格更优的产品和供应商。在半导体设备等高端产品方面,对物料技术要求较高,公司主要采购有技术支持的知名品牌产品,保证物料性能和品质。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入98,917.84万元,同比增加10,538.16万元,实现归母净利润7,997.57万元,同比减少4,276.23万元,主要业绩驱动因素包括:

1、电子热工设备领先优势显著,收入规模再创新高。

报告期内,受益全球电子产业逐步从欧美、日韩台向大陆转移,我国该类产业作为电子信息产业的关键环节始终保持较高景气度。加之国际形势复杂严峻,国内经济恢复发展,国内客户对生产设备国产替代的需求保持高位,以保证其产业链、供应链的自主可控。公司作为电子热工设备行业的领先企业,拥有电子热工领域核心技术,丰富的产品线覆盖PCBA生产制程中的插件、焊接、检测全流程,并提供多种配置可供选择,并具备完善的生产体系保证产品生产效率,产品交付周期短,快速响应了客户订单,产品质量、服务水平和技术能力得到广泛认可,在行业内形成了品牌知名度,成为众多客户的优先选择。报告期内,公司电子热工设备实现营业收入70,872.50万元,同比增长31.69%,该类业务收入规模再创新高。

2、加大前沿技术投入,各业务条线的产品结构升级。

报告期内,公司坚持自主研发创新,加大前沿技术研发力度,持续投入新产品和新技术的研发,扩展公司产品应用领域,丰富各产品线,推动各业务条线的产品结构升级:

(1)电子热工设备方面:追求精益求精,注重前沿技术的储备,努力突破更高技术含量的设备,始终保持技术水平领先行业,丰富并推动回流焊、波峰焊、选择焊等系列产品线及产品结构,并将相关产品应用范围延伸至Mini LED、新能源IGBT模块、储能产品、充电桩大功率电源主板、高端汽车电子产品等领域。

(2)半导体专用设备方面:公司在半导体热工设备和半导体硅片制造设备方面均实现关键技术突破,截至本报告披露日,部分半导体热工设备已顺利通过多家客户验收且复购,研制出的半导体硅片制造设备已向客户出货,部分客户已通过单机测试,进入客户产线验证阶段。该类设备的突破,证实公司具备向不同技术领域延伸的能力。

(3)光电显示设备方面:公司研制的折叠屏贴合设备、车载屏贴合设备和铜片贴合设备分别应用于折叠屏、车载屏和半导体复合铜片等的贴合工艺,研制的导电胶贴附机适用于穿戴类屏体上导电胶贴附功能,均已向客户交付。公司光电显示设备已积累了丰富的技术经验,能够满足客户多样化的需求。

产品结构升级是公司营收增长的重要驱动因素,有利于打开未来业绩成长空间,但是相关产品的前期投入全部费用化,"吃掉"不少当期利润。

3、原材料涨价致生产成本承压,部分战略性订单在本期验收拉低当期毛利率。

(1)报告期内,受国际大宗商品供需失衡影响,公司部分上游原材料价格上涨并保持高位波动,公司已通过与供应商建立长期合作关系等方式维持原材料价格平稳,但公司仍面临较大的生产成本上涨压力。

(2)报告期内,公司与部分客户(含头部国产面板厂商、头部国产手机厂商)签订战略性订单,毛利低但具备战略合作意义,为后续扩大合作规模奠定基础。该类订单在本期验收拉低了公司当期毛利率。

4、处置不良投资项目,清理产品业务条线,及时止损集中资源投入到更有前景的项目。

(1)处置不良投资项目:报告期内,公司全资子公司劲彤投资的原控股子公司精创因重要客户经营困难,导致精创货款难以收回,运营资金紧张,生产经营陷入困境,发生大额亏损,对公司整体合并报表造成较大的负面影响。

为维护公司和全体股东利益,及时止损,集中有限的投资资源投入到其他更富有前景的投资项目中,2021年12月公司全资子公司劲彤投资完成了其持有的精创全部62.75%股权的处置,报告期末劲彤投资不再持有精创股权。处置该项不良投资项目,并对该投资项目应收款项计提全额坏账准备,导致公司利润减少。

(2)清理产品业务条线:报告期内,部分传统业务中的低端产品线不具备市场竞争力,部分光电产品线的研发及收益不达预期,为及时止损,集中有限的资源投入到其他更具有成长性的产品线中,公司清理了部分产品业务条线,承担了部分损失和费用,对公司毛利率及净利润产生了一定负面影响。

(四)报告期内公司所处行业情况

公司所属行业为制造业,细分领域为专用设备制造业,主要从事专用设备的研发、生产、销售和服务,主要产品为1、电子热工设备:波峰焊(如全程氮气波峰焊、高端无铅波峰焊、无铅波峰焊)、回流焊(如真空回流焊、热风氮气无铅回流焊、热风无铅回流焊)、立式固化炉、选择焊;2、检测设备:自动光学检测设备(AOI)、自动锡膏检测设备(SPI)、智能激光指示仪;3、自动化设备:插件机、供料器、助焊剂喷雾机等周边设备;4、光电显示设备:3D贴合设备(如3D曲面贴合设备、D-Lami贴合设备、车载屏贴合设备、折叠屏贴合设备、上&下覆膜机等)、生物识别模组生产设备、LCM焊接类设备等;5、半导体专用设备:半导体热工设备(如半导体芯片封装炉、Wafer Bumping焊接设备、甩胶机、氮气烤箱等)、半导体硅片制造设备。

在工业设备制造领域当中,专用装备制造业是一项非常重要的内容,其经济运行状况对于我国社会经济的发展、工业领域的进步以及综合国力的提升等,有着至关重要的影响。专用设备制造业与上下游智能制造产业之间的联系十分紧密,其发展态势将直接影响智能制造业的发展情况。通过以智能制造带动装备制造业智能化升级,再以装备制造业智能改造推动智能制造在全行业普及的方式,可以更好的推进我国制造业的高质量发展。

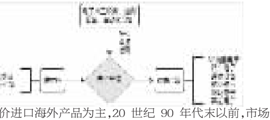
近年来,国家发布了多项政策,支持加快智能装备制造业的发展。2018年11月,国家统计局发布了《战略性新兴产业分类(2018)》,智能制造装备产业被纳入战略性新兴产业;《2019年政府工作报告》中指出,推动制造业升级和新兴产业发展;发展工业互联网,推进智能制造,培育新兴产业集群;2020年10月,发展改革委、科技部等六部委联合发布了《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》,提出实施机器人及智能装备推广计划;2021年12月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会等八部门联合发布了《"十四五"智能制造发展规划》,提出大力发展智能制造装备,推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合,通过智能车间/工厂建设,带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级;到2025年,智能制造装备技术水平和市场竞争力显著提升,市场满足率超过70%。公司相关业务主要行业情况如下:

(一)电子热工设备、检测设备、自动化设备行业及市场情况

1、行业发展状况

电子热工设备、检测设备、自动化设备是在将电子元器件、基板、导线、连接器等零部件按照设定的电气工程模型和电路设计功能,通过技术手段进行装配并实现电气联通的过程中采用的相关设备,是电子信息产业的重要组成部分,电子产品的电气连通性、性能稳定性、使用安全性都与该类设备的技术水平密不可分。

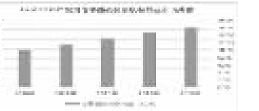
相关设备包含 SMT 设备、THT 设备、点胶设备、组装设备及其他周边设备等,下游主要为 3C 制造行业,主要应用于PCBA制程中的表面贴装工艺,是连接PCB产业链中上游电子制造和下游消费市场的关键环节,与PCB行业及下游行业的景气度密切相关,该类设备所处环节如下图所示:



该类设备发展之初,我国主要以高价进口海外产品为主,20 世纪 90 年代末以前,市场大部分由发达国家把控。随着近十几年来国家对于精密装备制造产业的大力政策扶持,行业发展迅猛,相关国产企业自主研发能力得到不断提高,新技术新工艺持续涌现,逐步建立完善的采购渠道和销售网络,提升服务能力和自身品牌形象,持续扩大国产企业的市场份额,以我司为代表的国产品牌逐渐在世界电子专用制造设备领域的金字塔式竞争格局中占据一席之地。目前在对速度和精度要求都极为严格的高尖端应用中,德国、美国和日本等发达国家仍占据主导地位,未来随着重点领域突破,各项专业技术不断提升,高尖端市场该类设备的国产率会不断提升。

2、行业市场规模

经过多年发展,中国已经成为全球最重要的电子信息产品生产基地以及电子信息产品消费市场,产业规模居世界前列,庞大的加工制造能力为该类设备的稳步发展提供了有利的市场环境。



资料来源:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年电子装联设备行业深度调研及投资发展趋势前景咨询预测报告》

近年来,中国大陆已成为全球最大的PCB生产基地,根据电子市场调研机构Prismark数据,2020年全球PCB行业总产值达652亿美元,到2025年,将增长到863亿美元,年复合增长率5.77%,2020年,中国大陆PCB行业产值占比53.8%。

电子热工设备、检测设备、自动化设备下游产业主要为电子信息制造业,2021年,全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%,电子信息制造业固定资产投资比上年增长22.3%。2021年,主要产品中,手机产量17.6亿台,同比增长7%,其中智能手机产量12.7亿台,同比增长9%;微型计算机设备产量4.7亿台,同比增长22.3%;集成电路产量3594亿块,同比增长33.3%。(数据来源:工信部网站)。

受益全球电子产业逐步从欧美、日韩台向大陆转移,我国该类产业作为电子信息产业的关键环节始终保持较高景气度。

3、未来发展方向

近年来,随着5G通信网络的成熟、移动互联网的普及、集成电路的发展、大数据的应用,智能终端等新兴消费电子、汽车电子等产品市场需求增长,推动PCB产品由简单、低端产品,向高技术含量、高性能产品发展,从而带动电子制造厂商加大设备投入。

同时对设备供应商提出了更高的技术要求:相关设备由单台向多台设备组合连线方向发展、由多台分步控制方式向集中在线控制方向发展、由单路连线生产向双路组合连线生产方向发展;设备智能化、灵活化发展,即利用远程互联网控制技术和人工智能技术,对生产工艺进行实时监控以及自动优化;设备环保化发展,即生产无铅化和低能耗以及低排放;同时随着电子元器件逐渐向小型化方向发展,封装方式不断变化,各种新技术、新工艺在电子设备制造过程中不断更新和推广应用,该类设备未来会向更高精度、高速度、多功能方向发展。

此外,随着下游产品个性化、多样化趋势明显,相关厂商不仅需要有提供标准设备服务的能力,也需要具备根据客户需要,提供方案设计、功能选择、安装调试、工艺技术支持等非标准设备服务的综合能力。

(二)半导体专用设备市场情况

半导体设备指用于生产各类半导体产品所需的生产设备,属于半导体产业链的关键支撑环节,主要运用于集成电路的制造和封测两个流程,包括前道工艺设备、后道工艺设备和其他设备,前道工艺设备为晶圆加工设备,后道工艺设备包括检测设备和封装设备,其他设备包括硅片生长设备等。

目前公司半导体专用设备包含半导体热工设备和半导体硅片制造设备,半导体热工设备是指半导体制造和封测流程中使用热处理工艺的半导体设备,目前公司半导体热工设备主要用于封测流程,半导体硅片制造设备主要用于半导体硅片的生产制造过程。

1、行业政策环境

半导体行业是电子信息产业的重要基础,是国家重点鼓励发展的战略性产业,为了大力发展半导体行业,加速推进相关设备自主可控,国家和各级政府亦出台了一系列鼓励政策支持半导体及半导体设备制造业的发展,营造了良好的政策环境。2015年,《中国制造2025》提出,提升封装产业和测试的自主发展能力,形成关键制造装备供货能力;2016年,《"十三五"国家科技创新规划》,提出,持续攻克集成电路装备等关键核心技术,着力解决制约经济社会发展和事关国家安全的重大科技问题;2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,瞄准集成电路等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目,集成电路领域包括设计工具、重点装备等;《广东省制造业高质量发展"十四五"规划》提出,加快培育半导体与集成电路、高端装备制造等十大战略性新兴产业集群,推动部分重点领域在全球范围内实现并跑领跑发展,以广州、深圳、珠海为核心,打造涵盖设计、制造、封测等环节的半导体及集成电路全产业链;依托珠三角地区,加快半导体集成电路装备生产制造。

2、市场环境情况

在全球半导体制造产能持续紧张背景下,近年来半导体设备市场发展迅速,半导体设备投资支出持续增加。根据国际半导体产业协会SEMI数据,2021年1-9月全球半导体设备市场规模为752亿美元,同比增长45.5%,2021年全年预计为1030美元,同比增长45%;全球前端晶圆厂设备支出预计将在2022年同比增长10%,达到超过980亿美元的历史新高。国家工信部数据显示,近两年我国集成电路相关领域投资活跃,实现半导体器件设备、电子元件及电子专用材料制造投资额的大幅增长,带动电子信息制造业固定资产投资两年平均增长17.3%,远高于制造业两年平均的5.8%。

数据来源:国际半导体产业协会SEMI

目前,在中国进口的产品中,芯片已经连续多年超过石油成为中国进口最多的商品。芯片关系到国家安全和主要经济命脉。按照中国海关数据,2021年我国进口集成电路数量6,354.81亿,同比2020年增长16.9%。进口金额达27,934.8亿人民币(约合4,397亿美元),同比去年增长25.6%。国内半导体产业对国外的依赖仍然非常严重。近年来,美国在半导体和集成电路领域对中国进行限制,对国内多家相关企业和单位实施"制裁",据《首尔经济日报》等媒体报道,美国政府提议与韩国、日本和中国台湾成立"芯片四方联盟"(Chip4),以建立半导体供应链,并借此遏制中国大陆地区的半导体产业发展。国内半导体产业发展形势依然严峻。

3、未来发展方向

根据调研机构VLSI Research数据,2020年全球半导体设备厂商Top15均为国外厂商,营业收入合计占比82.6%。目前中国大陆已成为最大的半导体设备市场,但半导体设备主要被国外厂商占据,国产化率较低,供给和需求不平衡,在国际贸易摩擦的背景下,国产替代需求非常迫切。根据国际半导体产业协会SEMI数据,2020年全球半导体封装设备市场规模为38.8亿美元,占整个半导体设备市场规模约5%;前道量测设备市场规模34.1亿美元,占全球半导体设备市场规模约5%;后道测试设备市场规模60.2亿美元,占全球半导体设备市场规模约8%,公司半导体专用设备的主要国内外竞争对手有新加坡、美国、德国、日本等相关设备制造商。2021年,半导体行业产能不足成为制约整个产业发展的瓶颈,其严重性不但冲击了全球各个产业,SEMI预计全球半导体晶圆厂资本开支规模有望持续提升至1,270亿美元,同比增长13%。

近年各晶圆厂、封测厂扩产的动能非常足,纷纷发布晶圆制造扩产计划,加大资本开支,其中大部分来自半导体设备的开支。半导体景气周期来临的时候,大致遵循设备先行的规律,国产半导体设备厂商迎来了发展的机会。伴随着半导体行业资本开支持续拔高,半导体设备行业景气度有望不断提升,半导体设备厂商有望进一步受益。

(三)光电显示设备市场情况

1、行业发展状况

公司光电显示设备主要用于光电平板显示模组的生产制造过程。目前,显示面板产业中,TFT-LCD工艺发展时间长,生产良率高,造价成本低,在显示面板产业中保持着绝对的优势;具有高对比度,低功耗、柔性化等特点的AMOLED面板,在中小尺寸面板的应用中大放异彩,快速渗透于智能手机、AR/VR头显、可穿戴市场中;Mini LED拥有高对比度的同时还具有长寿命、不易烧屏的优势,目前成本较高,主要运用于高端显示领域。

2、未来发展方向

工业和信息化部副部长在2021世界显示产业大会上指出,在关键领域创新突破上,新型显示产品与 5G 通信、超高清视频、人工智能、虚拟现实、物联网等新型产业加速融合创新,在汽车电子、远程医疗、工业控制等领域取得丰硕成果,形成了行业增长新动能。根据群智咨询的数据,2020年全球显示面板产值突破1,100亿美元,达到1,146亿美元,同比增长13%。目前液晶显示仍占主流市场,OLED市场占有率稳步提升,集成化趋势明显加强,而Micro LED技术突破进入攻坚期,Mini LED 随着成本下降,企业端市场进入快速爆发期。

市场调研机构Counterpoint Research发布的数据显示,2021年OLED面板占全球智能手机市场42%,较2020年成长10个百分点,预估2022年OLED智能手机成长速度放缓。受OLED显示驱动IC芯片供应短缺影响,全球OLED产能扩张受限,手机OLED光电显示设备面临需求下降的压力。

(四)公司所处的行业地位

1、公司自成立以来,一直从事电子制造设备的研发、生产和销售,经过多年发展,公司在电子热工设备行业处于领先地位,被行业协会授予"SMT领域龙头企业"。公司自主研发的检测设备和自动化设备实现对电子热工设备的辅助和功能扩展,丰富了公司产品的应用场景,与电子热工设备配合为客户提供覆盖电子产品PCB生产过程中插件、焊接和检测的整套系统解决方案。

2、公司回流焊设备荣获国家工信部"制造业单项冠军产品"认证,该项评选极为严格,必须达到长期专注于制造业细分产品市场、生产技术或工艺国际领先、单项产品市场占有率位居全球前列这三个标准。

3、公司光电显示产品已经覆盖AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域,积累了丰富的技术经验,能够满足客户多样化的需求;自主研制的多款进口替代光电显示设备,成功得到头部国产面板厂商和大型模组厂的认可和验收,顺利进入多家客户的供应商体系,并持续为客户供应产品和提供服务。

4、公司半导体业务已实现关键技术突破:(1)将自身产品技术积累扩展至半导体专用设备领域,研制出一系列半导体热工设备,已向多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货。截至本报告披露日,部分设备已顺利通过多家客户验收及复购;(2)引入成熟的研发团队,结合自身较强的生产制造能力,成功在半导体硅片制造设备领域实现技术突破。截至本报告披露日,研制出的半导体硅片制造设备已向客户出货,部分客户已通过单机测试,现进入客户产线验证阶段。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,231,839,311.01	1,182,209,226.79	4.20%	1,070,119,932.95
归属于上市公司股东的净资产	747,809,852.71	673,487,061.63	11.04%	537,004,508.29
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	989,178,447.86	883,796,809.80	11.92%	495,387,014.88
归属于上市公司股东的净利润	79,975,673.48	122,738,020.79	-34.84%	22,572,830.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,515,680.10	108,648,137.86	-43.38%	8,514,433.40
经营活动产生的现金流量净额	17,626,349.28	262,339,807.14	-93.28%	-31,018,620.13
基本每股收益(元/股)	0.33	0.52	-36.54%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.51	-35.29%	0.09
加权平均净资产收益率	11.30%	20.71%	-9.41%	4.03%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	214,833,790.05	253,488,390.54	269,633,366.74	251,222,900.53
归属于上市公司股东的净利润	34,882,777.56	47,757,663.38	23,606,124.21	-26,270,891.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,640,791.23	43,266,448.37	22,928,372.77	-36,319,932.27
经营活动产生的现金流量净额	42,003,733.73	34,913,401.71	5,699,549.24	-64,990,335.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,191	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴限	境内自然人	32.86%	79,729,018	59,796,763	质押	24,618,182
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.92%	7,095,180	0	--	--
麦旺球	境内自然人	2.19%	5,314,749	0	--	--
主逵	境内自然人	2.10%	5,084,935	0	--	--
中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金	其他	1.65%	4,000,950	0	--	--
麦容章	境内自然人	1.57%	3,814,571	0	--	--
邱子聪	境内自然人	1.53%	3,720,000	0	--	--
孙见清	境内自然人	1.52%	3,700,000	0	--	--
陈路	境内自然人	1.34%	3,260,000	0	--	--
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.22%	2,960,820	0	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司实施完成了2020年年度权益分派方案,合计派发现金红利人民币23,966,498.00元(含税)。《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-028)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、报告期内,公司全资子公司劲彤投资出资1,200万元投资设立公司控股孙公司深圳市思立康技术有限公司,出资占比60%。《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-026)、《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-027)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、报告期内,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意对公司回购专用证券账户中剩余的2,960,820股回购股份的用途进行变更,由"用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"用于员工持股计划或者股权激励"。《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2021-049)详见巨潮资讯网。

4、2021年6月28日,公司全体非独立董事、监事及高级管理人员(除部分不具备创业板交易权限的监事和高管外)计划自本增持计划披露日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份,增持金额合计不少于1,000万元,不高于2,000万元,本次增持计划价格区间为不高于22元/股。报告期内,本次股份增持计划实施期限届满,本次计划增持主体均完成了增持计划,增持股份合计454,400股,增持金额合计10,045,230.97元(不含交易费用)。

报告期内,公司生产经营活动正常,除上述事项外,报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2021年度报告》。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码:300400　　证券简称:劲拓股份　　公告编号:2022-004

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2021年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司2021年度报告于2022年4月23日在符合条件的信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2022年4月21日,深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2021年度报告及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况,公司《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》于2022年4月23日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网上披露,巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码:300400　　证券简称:劲拓股份　　公告编号:2022-005

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司2022年第一季度报告于2022年4月23日在符合条件的信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2022年4月21日,深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2022年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况,公司《2022年第一季度报告》于2022年4月23日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网上披露,巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2022年4月23日